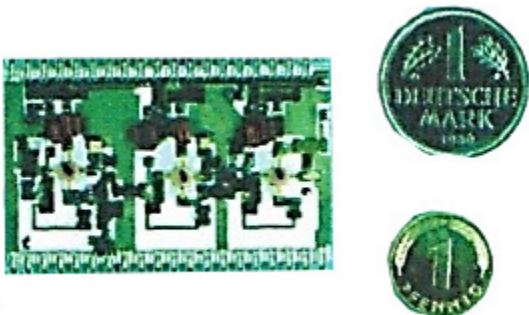


Hybridtechnologie

Die Richtfunktechnik erforderte im Verlauf ihrer Weiterentwicklung stets die Anwendung neuer Technologien, um effizientere und technisch leistungsfähigere Lösungen einsetzen zu können. In der zweiten Generation waren das galvanoplastisch hergestellte Radiofrequenzfilter und schutzgasgelötete Gehäuse. Mit der digitalen Richtfunktechnik der dritten Generation kamen Flachstrukturen in Dick- und Dünnschichttechnik hinzu. Aus dem Technologielabor der Grundlagenabteilung wurde 1976 in der Entwicklung eine selbständige Abteilung Hybridtechnologie im F-Gebäude aufgebaut.

1987 entstand nach vierjähriger Projekt- und Bauphase mit erheblichem Investitionsaufwand im ehemaligen Wareneingangsgebäude das **Entwurfs- und Kleinfertigungszentrum Hybridtechnologie (EKfZ)**. Dort wurden die Flachstrukturen für die Mikrowellentechnik und andere Bauelemente der Mikroelektronik in Dick- und Dünnschichttechnik gefertigt.



Das Bild zeigt einen Breitbandverstärker in Dickschichttechnik für den Frequenzbereich bis 800 MHz

Nach der Einleitung der **Gesamtvollstreckung der Robotron-Telecom GmbH** im Januar 1991 gestattet der Verwalter unter Auflagen die Weiterarbeit als "**Geschäftsidee Hybridelektronik**", eine Übernahme der Geschäftslinie mit 70 Mitarbeitern in die ANT ist nicht möglich.

28 Mitarbeiter bewerben sich als Gesellschafter einer zu gründenden GmbH und bringen das Gründungskapital mit 54,5 TDM auf. Die **Gründung der "Radeberger Hybridelektronik"** als GmbH erfolgt im Mai 1991, bis zum Jahresende werden die Geschäfte vom Verwalter weitergeführt. Zum Jahresanfang 1992 erfolgt der Geschäftsbeginn der Radeberger **Hybridelektronik GmbH (RHe)** mit 23 Mitarbeitern.

Im April 2004 wird das Unternehmen in **RHe Microsystems GmbH** umbenannt, im Mai 2005 sind 53 Mitarbeiter angestellt.

Am 3. April 2007 wurde in Radeberg der Vertrag über die Integration der RHe Microsystems GmbH (RHe) in die Schweizer Industriegruppe Cicor Technologies unterzeichnet.